

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	Dymon Asia:徐磊 Power Corporation of Canada:张笑石 ZY Investment:张萍 北京才誉资产管理企业:石林 博时基金管理有限公司:田俊维 财通证券股份有限公司投资管理部:郭琦 广发基金管理有限公司:王丽媛 广州市航长投资管理有限公司:麦浩明 华宝信托投资有限责任公司:顾宝成 华富基金管理有限公司:范亮 嘉实基金管理有限公司:谢泽林 建信基金管理有限责任公司:张文浩 进门财经:付超 进门财经:李文娟 进门财经:李雨桐 茂典资产:子丰 美的-盈峰资本:刘东渐 平安证券股份有限公司:李峰 上海电气集团财务有限责任公司:赵梓峰 上海海岸号角私募基金管理有限公司:刘泽

	<p>上海庐雍资产管理有限公司:彭永锋</p> <p>上海天猷投资管理有限公司:曹国军</p> <p>深圳达昊控股有限公司:王鹏飞</p> <p>深圳市尚诚资产管理有限责任公司:黄向前</p> <p>盛世景资产管理集团股份有限公司:熊英</p> <p>双安资产:LiuXinCheng</p> <p>天治基金管理有限公司:顾申尧</p> <p>通用技术创业投资有限公司:侯锐骁</p> <p>通用技术创业投资有限公司:刘洋</p> <p>西藏合众易晟投资管理有限责任公司:李敏生</p> <p>循远资产管理(上海)有限公司:田超平</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司:胡纪元</p> <p>中金公司:郭威秀</p> <p>中金公司:王月峥</p> <p>中金公司:王月峥</p> <p>中意人寿保险有限公司:臧怡</p> <p>中银基金管理有限公司:王寒</p> <p>安邦资产:钱怡</p> <p>广东惠正投资管理有限公司:伍卫</p> <p>广东正圆私募基金管理有限公司:张萍</p> <p>广发基金管理有限公司:曾质彬</p> <p>杭州遂玖资产管理有限公司:章诚</p> <p>华夏财富创新投资管理有限公司:刘春胜</p> <p>进门财经:林晓莹</p> <p>茂典资产:卞洁</p> <p>上海贵源投资有限公司:赖正健</p> <p>上海原点资产管理有限公司:石翔</p> <p>友邦保险有限公司:许敏敏</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司:胡纪元</p> <p>征金资本:谢丰</p>
时间	2024年8月16日
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎 财务总监 林振荣

投资者关系活动主要内容介绍

1、公司整个下游应用结构如何，包括半导体领域的现状如何？

上半年，公司在3C自动化领域应用的营收有较好的回升，在公司整体营收占比从23年底的22%+回升到25%+。

在半导体/泛半导体设备领域。我们首先看到的整体上公司的部件与系统产品在此领域的应用仍然保持较快的增长，营收占比从23年底的13%，增长到15%+。从半导体设备内部细分来看，前道设备和后道设备的应用落地进度存在差异，其中前道整体上相对较慢，几个主要工业设备节点的应用部署整体上仍处于批量前期；而半导体后道设备比如键合、固晶、划片等主要工艺设备在应用中落地较快，批量商业应用落地场景较为丰富。

公司在数控机床与工业激光应用领域，上半年有较为平稳的表现，营收占比维持在26%。

公司上半年在工业机器人、通用自动化领域有一定承压，在公司营收结构占比相对23年底，都有1~2个百分点的回落。

整机设备业务规模较小，目前未能平衡季度周期现象，相对23年有所承压，在整体营收中占比回落约6个百分点，上半年营收占比约8%。

鉴于多种因素叠加，大陆地区半导体/泛半导体设备领域近几年持续保持了较为快速的成长态势。

半导体设备领域的情况从企业自身感知来看，大致有以下两点可以分享，数字不一精准：

首先，市场规模较大。从半导体/泛半导体设备、数控机床两个典型的高端装备子领域来看，半导体/泛半导体设备市场规模在1500亿元以上，数控机床市场规模在四五千亿。这两个典型的高端装备领域所对应的控制、伺服、传感等设备内部模块与系统的市场规模约三五百亿。这个市场空间，相对之前十多年的通用自动化装备所牵引出来的三五百亿核心部件与系统的市场，是另外一个细分的市场空间。

其次，这些高端装备领域的部件、系统竞争格局较为广阔。以半导体/泛半导体设备为例，这些装备内部模块、系统的供应目前主要还是ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等；高端数控系统供应业界都知道主要还是Fanuc、西门子、三菱与海德汉。

在这些高端装备应用领域，公司更侧重于技术的实际应用和落地。我们携手各主机客户专注于逐个解决对应领域的设备技术、功能、工艺与可靠性问题，伴随着客户、行业一点点地去夯实高端制造业的基础。比如在半导体前道工艺中，尽管整体上前道设备进度较后道设备商业进展稍慢，但各大工艺节点设备基本有导入。沉积节点商业进展相对偏快，刻蚀、清洗、光刻相关的商业进展相对模糊，但整体上半导体设备国产化、设备内部件与系统国产化都在稳定地逐步推进中。

展望未来三几年，在整个产业自主可控、制造业升级转型大背景下。半导体设备行业可能仍将保持较为稳健的增长，释放出较好的部件与系统的需求。我们将继续关注行业动态，把握发展机遇，以实现持续的增长和突破。

2、前道设备的前期验证周期通常需要多长时间？

前道设备的验证周期很大程度上取决于客户的具体要求。一旦部件系统在主机中定型，我们还需进一步进行机器的验证和上限测试。这些都涉及对生产进度的严格把控，以及对主机生产的验证。产品的功能和性能需要经过彻底的验证。

目前看来，公司的部件、系统在半导体装备领域发展格局较好。在半导体、泛半导体设备领域，企业的产品主要是部件类产品。该领域市场上领先企业主要是ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等。

在半导体/泛半导体后道加工设备中，公司的控制、伺服部件产品，以及系统类产品已进入批量应用部署阶段。在刻蚀、清洗、沉积、光刻为代表的半导体前道加工设备中，进展相对后道稍慢，大多数还处于批量应用前期。

3、3C自动化的趋势是否会对下游市场的占比产生影响？您对下半年和明年的市场有何看法？

根据上半年的观察，3C自动化领域出现了一些变化。

整体而言，市场呈现出一定的上升态势。公司基于最新市场行情回暖持谨

慎乐观态度。这个态势能否延续，公司也在持续观察中；详细数据反映请以定期报告为准。

4、机器人板块和通用自动化的关联性较高，目前市场压力如何？公司有何应对策略？

受整个环境影响，公司的机器人业务和通用自动化业务确实面临一定的压力，上半年营收占比都有一定回落。

在机器人领域，企业、也可能是整个行业目前遇到的挑战是：任何构型的机器人，包括工业、协作，人形等，都需要业界的探索、找出更多的高价值的应用场景并落地；行业的商业闭环需要挖掘放大。基于自身技术、产品与业务发展，公司会配合行业客户跟进技术演变，并做更多应用尝试。

5、固高公司在GMC方面有哪些特点和优势？

固高公司自成立之初就专注于“控制”与“网络”的结合，通过高速网络实现数据的无缝连接和高实时性控制。我们在控制和网络架构方面进行了深入整合，根据不同行业的需求提供解决方案。同时，我们的产品设计具有通用的模块化结构，结合了软件架构和底层硬件架构，能够灵活复制和定制，以适应不同行业的需求。

6、公司如何平衡研发投入与产出效益？

企业在接下来五年到十年间，核心的发展机遇是为以半导体、高端数控为代表的高端装备提供技术、产品解决方案。

以半导体装备、高端数控为代表的高端装备内的部件与系统传统以欧美日为主导，设备种类多，性能可靠性要求高。

这部分高端装备整体上导入了一个三五百亿规模的市场空间；竞争格局也开阔充沛，但企业自身需要有充足的技术、产品、服务能力以满足该领域的需求。

所以从企业自身的发展路径出发，接下来两三年，公司会重点夯实服务能力、高端技术与产品能力，持续深入半导体/泛半导体、高端数控机床的

各种工业设备节点，理解并实现各工业设备的特性、性能与功能需求，最终形成完善的技术与产品解决方案，逐步构建出稳定、持续的商业结构，在逐步放大相关营收的过程中，最终在营收规模攀升基础上实现研发投入与产出效益的新平衡。

简单来说，企业预计现阶段与接下来一两年可能仍会有较高比例的研发投入，以完成对高端装备多工艺设备节点的技术方案完善与服务支撑，并最终通过做大营收分母来实现研发投入占比新平衡。

7、公司的毛利率面临压力，这是否与产品结构有关？中报后毛利率的稳定性是如何实现的？

是的。公司的控制类产品线毛利较高，控制类整体增长较为平稳。

公司伺服产品线快速增长，且毛利持续攀升，但毛利相对控制产品线仍然偏低，综合线路来看拉低了整体毛利。

系统类、整机类业务基数较低，增速较快，且毛利季节波动偏大。

此外，汇率波动与市场竞争也对毛利有一定影响。

整合下来，公司综合毛利整体上有波动，且伴随非控制器业务的成长会在结构上对毛利有所压制。公司期望伺服业务线营收、毛利双攀升到一个稳定阶段后，公司毛利在整体上能进入相对稳定的结构。

8、今年激光领域的市场情况如何？以往是否存在压力？

激光技术与CNC领域相对比较稳定。

传统的工业激光设备领域应用有一定承压，但激光五轴技术在切割和焊接复杂曲面方面展现出其优势，我们对此持续关注并持乐观态度。

此外，企业将激光设备控制技术与数控系统技术进行了整合，技术路径和产品结构趋于一致。

9、国产替代是否已经影响到零部件厂商？公司如何看待这一趋势？

高端数控领域核心部件自主化确实有一定的影响，2023年与上半年有较多

	<p>的高端数控典型机型正在进入测试验证，进度较快的机型已进入批量应用部署。但从整体上来看，高端装备核心部件国产的传导期偏长，设备的调试、验证、应用部署周期较长，目前公司相关的商业营收基数较小，短期内对公司整体营收贡献并不突出。</p> <p>10、半导体设备、高端数控系统一直都是很难进入的领域，公司为什么可以定位要发展该领域，公司的相关技术与产品有基础吗，是否源自外部？公司自成立之日起，创始人给予企业的定位就是解决高端装备领域的核心技术问题。</p> <p>基于此目标，企业基于自主研发模式，构建了运动控制、伺服、工业总线、感知与软件等全栈可控的技术体系。并在之前十多年间，抓住LED芯片发展中涌现功率半导体/泛半导体后封装设备如键合机、固晶机等应用机遇实现在该领域的应用落地并持续迭代、优化相关技术与产品，拓展应用落地场景；抓住3C消费电子产品，特别是智能手机生产中金属边框等金属部件加工中涌现的CNC需求机遇，实现相关技术、产品在数控系统的应用落地，同时持续迭代、优化，并积极拓展多种高端数控机床应用领域。</p> <p>综上，以半导体设备、高端数控机床领域的技术、产品与应用落地来推动企业发展，是基于企业自身的愿景，长期技术积累与应用基础做出的可行性高、可持续发展的战略决策；也是能在中长期持续为股东、为社会带来回报的可行路径。</p>
附件清单（如有）	无